2023年半导体所拟许可专利情况公示（二）

公示时间：2023年3月23日至2023年4月6日 联系人：曹永胜 邮箱：yscao@semi.ac.cn 电话：82304880

序号	专利名称	发明人	专利号	所属研究组	研究组负责人	许可形式	拟许可的公司	拟许可金额（万元）
1	基于 VR 技术的元宇宙物体材质构建方法及装置	王丽丽, 李林林	202211022359. X	柔性传感与系统集成研究组	王丽丽	排他许可	长春致远机械设备 有限公司	60